



△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
  - めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

				Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
				WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
				mm(AWG) -	mmφ	12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
				MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
				SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	10% ±0.3	SIZE LOC NUMBER
				DR. 23 JUN 95 N. Matsubara	DE. 23 JUN 95 N. Matsubara	10% ±0.4	A3 J C-178306
				DR. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA	APP. 3 JUL 95 S. MANABE	30% ±0.45	SCALE REV. SHEET
				LTR REVISION RECORD	DR CHK DATE	角 度 : ±3'	2-1 B1 1 OF 1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178306-2](#)